

LPKF ProConduct

Leiterplatten chemiefrei durchkontaktieren

Artikel: LPKF ProConduct
Art.-Nr.: 115790
Bestell-Info: Siehe Umschlag vorne

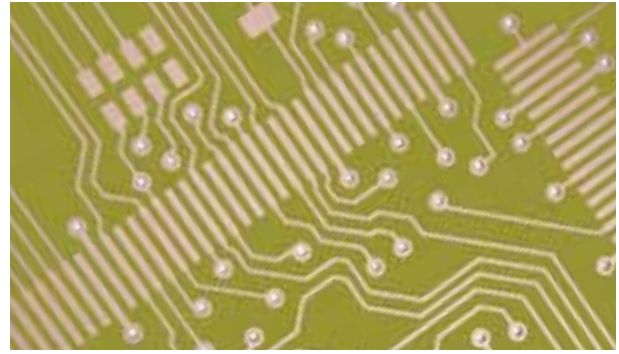


LPKF ProConduct ist ein neuartiges System für die wirtschaftliche Durchkontaktierung ohne Nasschemie. Es benötigt keine Galvanikbäder. Der parallele Prozess kontaktiert auch Leiterplatten mit einer hohen Anzahl an Bohrungen schnell, einfach und sicher durch.

ProConduct eignet sich perfekt für kleine Stückzahlen sowie Labore und Betriebe, für die chemisches Galvanisieren nicht praktikabel ist.

In Kombination mit einem LPKF-Fräsbplotter oder ProtoLaser S ist das LPKF ProConduct-System eine Schlüsselkomponente des Inhouse-Leiterplatten-Prototyping. Es ermöglicht eine sichere, flexible und schnelle Prototypenherstellung.

- Keine Galvanikbäder oder Chemikalien erforderlich
- Zuverlässige und temperaturbeständige Durchkontaktierungen
- Platzsparend
- Schnelle und einfache Handhabung
- Auch für PTFE und andere anspruchsvolle Substrate



Einfache Handhabung

Kernstück von LPKF ProConduct ist eine spezielle Durchkontaktierungs-Paste. Sie wird mit einem Vakuum durch die Bohrlöcher gezogen – der einfache Prozess zur nahtlosen Beschichtung führt in wenigen Minuten zum perfekten Ergebnis.

i Weitere Infos und eine Prozessbeschreibung siehe Technische Daten ab Seite 96.

Zubehör

- Heißluftofen (Art.-Nr. 115877)
- Vakuumentisch (Art.-Nr. 115878)
- Staubabsaugung (Art.-Nr. 114647)

Weiteres Zubehör ab Seite 66.

Zuverlässige Kontakte

Das LPKF ProConduct-System metallisiert Durchgangslöcher von bis zu 0,4 mm (15 Mil) und einem Aspektverhältnis von 1:4. Bohrungen mit geringerem Durchmesser sind unter speziellen Bedingungen möglich. Der Basisprozess benötigt sowohl für zweiseitige als auch für Multilayer-Leiterplatten nur wenige Minuten. Der elektrische Widerstand der Durchkontaktierungen mit LPKF ProConduct ist mit knapp 20 mΩ extrem niedrig.

Technische Daten: LPKF ProConduct	
Art.-Nr.	115790
Max. Basismaterialgröße	229 mm x 305 mm (9" x 12")
Min. Lochdurchmesser	0,4 mm (15 Mil) bis zu einem Aspektverhältnis von 1:4 ^a
Anzahl Durchkontaktierungen pro Leiterplatte	Keine Beschränkung
Anzahl der Lagen	4
Lötbarkeit	Reflow-Löten 250 °C (482 °F), manuelles Löten 380 °C (716 °F) ^b
Basismaterialtypen	FR4, HF- und Mikrowellen-Materialien (inkl. PTFE-basierender Materialien)
Prozessdauer	ca. 35 min
Elektrischer Widerstand (Lochdurchmesser 0,4– 1,0 mm bei 1,6 mm / 63 Mil Materialstärke)	Durchschnittswert 19,2 mΩ mit Standardabweichung von 7,7 mΩ

a Kleinere Lochdurchmesser auf Anfrage

b Empfehlungen von Lötmitte auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.